

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

中颖电子股份有限公司
2026 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告



二〇二六年四月

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称“本次发行”）。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目	23,067.40	15,500.00
2	高端工业级（含车规）主控 SoC（含智能化）研发及产业化项目	63,951.80	42,500.00
3	补充流动资金	42,000.00	42,000.00
合计		129,019.20	100,000.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金等方式解决。

若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金项目的具体情况及可行性分析

（一）高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目
实施主体	中颖电子股份有限公司、西安中颖电子有限公司、合肥中颖电子有限公司
项目总投资	23,067.40 万元
项目建设期	4 年

<p>项目建设内容</p>	<p>本项目将基于公司现有的电池管理技术，解决高精度采集、高压高安全、电流主动均衡与热管理协同等技术问题，面向车规以及工业、储能下的应用场景，开发高功能安全的电池模拟前端、桥接芯片及相关的模拟、数模混合芯片，为新能源汽车及储能等领域提供完整的电池解决方案，同时研发工业类高串数的电池模拟前端，加强在轻型电动车以及户外储能领域的优势地位。项目计划在合肥、西安和上海三地开发，引入项目研究所需人员，在 4 年左右的周期完成新产品的设计、验证，并最终实现量产。</p> <p>项目产品将运用在新能源汽车、工商业储能、家庭储能、户外储能、轻型电动车以及各种锂电工具等领域。项目的实施有助于公司抓住市场发展窗口期，丰富公司产品矩阵，提升公司盈利能力。</p>
<p>项目建设地点</p>	<p>安徽省合肥市、陕西省西安市、上海市</p>

2、项目实施的必要性

(1) 把握车规、储能等领域电池管理芯片（BMIC）国产替代机遇，打造新的增长点

当前全球电池管理芯片市场正处于高速增长阶段。根据 Fortune Business Insights 的数据,2025 年全球电池管理 IC 市场规模达 83.4 亿美元,预计将以 7.99% 的年复合增长率在 2034 年增长至 166.6 亿美元;据 IIM 信息分析,中国 BMIC 市场占全球近 40% 的份额。从细分领域来看,新能源汽车与储能系统已成为行业增长的核心动力。根据 IIM 信息发布的的数据,电动汽车领域贡献了全球电池管理芯片市场 65% 的需求;同时,储能领域增长强劲,其中户用储能系统年需求增速超过 50%,成为增速最快的细分市场。

从市场竞争格局来看,全球电池管理芯片市场呈现寡头垄断特征,德州仪器、亚德诺、英飞凌等国际厂商合计占据全球 70% 以上的市场份额,依托深厚的技术积淀和完善的车规认证优势,牢牢掌控车规电池管理芯片市场。国内厂商虽已在消费电子 BMIC 领域实现技术突破与市场布局,但在车规、储能等高端产品领域的国产化率仍处于较低水平,存在巨大的国产替代市场空间。同时,随着新能源汽车 800V 高压平台的逐步普及以及工商业储能装机量的爆发式增长,市场对 BMIC 的高精度、高可靠性、高集成度需求持续提升,为具备核心技术实力的国产芯片厂商提供了广阔的市场发展机遇。

(2) 加强 BMIC 技术储备和方案设计能力,提升公司整体竞争力

完整电池管理系统主要由以下几类芯片构成：AFE（模拟前端）、MCU（微控制器）、电量计、数字隔离通讯接口芯片。其中，AFE 芯片负责高精度电池电压等信息采集。电量计既可以是独立芯片，也可集成于 MCU 中。MCU 作为 BMS 的核心控制单元，负责接收 AFE 和电量计的采集数据，并与系统其他模块进行交互。在 BMS 中，车规 AFE 芯片凭借其高安全性、高可靠性、高性能、高压等要求，技术门槛极高，被业界称为“模拟芯片的皇冠”。

在储能系统中，大储电芯一致性差，传统被动均衡效率低、发热大，而主动均衡对 AFE 的驱动与控制要求极高。在新能源汽车快充场景下，AFE 需具备毫秒级的均衡响应能力，以满足高压快充对动态响应的严苛需求。此外，随着电池能量密度不断提升，热失控预警窗口已从秒级压缩至毫秒级，要求 AFE 具备超高速采样能力及硬件级故障触发功能。这些技术痛点对 AFE 在高精度采样、快速响应、可靠控制等方面的设计提出了更高要求。

本项目将聚焦于高压、高安全的电池管理芯片的技术开发，在公司已经积累的电池管理技术的基础上，针对上述开发难点，探索先进的电路设计与工艺技术，开发高功能安全的电池模拟前端、桥接芯片及相关的模拟、数模混合芯片，为新能源汽车及储能等领域提供完整的电池解决方案，同时研发工业类高串数的电池模拟前端，积累高功能安全的电池管理芯片设计能力，提升公司核心竞争力。

（3）丰富公司产品矩阵，构建“主控+电源+电池管理”的系统方案提供能力

公司长期耕耘电池管理赛道，已经在轻型电动车、电动工具、户外储能等领域有成熟的产品矩阵和竞争优势，为公司构筑了持续而稳健的业务基础。为了持续保持竞争优势，提高产品的护城河，公司需积极主动拓展产品能力边界，加速向具备高价值、高增长潜力、同时国产化水平较低的领域（新能源汽车、工商业储能）延伸，打造新增长曲线。

项目实施后，公司产品将进入车规、储能芯片核心赛道。对公司发展具有三重核心战略价值：其一，完善公司现有电池管理芯片以消费/工业电子场景为主的业务布局，实现产品向高附加值的车规、储能领域延伸，深度契合公司“高端化、多元化”的发展战略；车规与储能业务具备认证壁垒高、客户粘性强、产品生命周期长的特点，有助于公司拓宽产品下游应用领域，打造企业稳健增长的

新业务支柱。其二，紧抓国产替代的行业机遇，依托公司在电池管理芯片领域多年积累的技术优势，突破国际厂商的市场垄断，填补公司在车规级 BMIC 领域的产品空白，完善全场景覆盖的电池管理芯片产品矩阵。其三，构建“主控+电源+电池管理”的系统方案提供能力，BMIC 与公司 MCU、电源芯片可形成高度协同，打造面向新能源整车、储能系统的一站式芯片解决方案，显著增强公司对客户的绑定能力与服务价值。

3、项目实施的可行性

(1) 项目契合国家战略与产业政策导向，具备政策可行性

目前我国已将集成电路产业确立为支撑经济社会高质量发展和保障国家安全的战略性、基础性产业。2025 年 12 月，全国工业和信息化工作会议提出要“打造集成电路、新型显示、新材料、航空航天、低空经济、生物医药等新兴支柱产业”，并部署实施新一轮重点产业链高质量发展行动。新能源汽车与新型储能作为电池管理芯片的两大核心下游市场，均获得相关政策支撑。在新能源汽车领域，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局三部门于 2026 年 3 月联合召开行业座谈会，明确要求“加快补齐汽车芯片、基础软件等短板，推动扩大应用规模，迭代提升质量性能”，直接指向车规级芯片的国产化替代与质量提升。在储能领域，工业和信息化部等八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》（工信部联电子〔2025〕7 号）提出，要“提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片、大功率高效变流器等关键核心器件与部件供给能力”，并在专栏中强调“发展系统级主动均衡技术，探索基于端边云架构的先进储能系统高效高精度管理技术”，为电池管理芯片的储能应用提供了明确的政策指引。

本项目围绕车规、储能等电池管理领域，设计符合最新的高压、高可靠要求的电池模拟前端以及桥接芯片，提高国内厂商在车规、储能领域 AFE 的国产化率，符合国家和产业政策导向，项目建设具备政策可行性。

(2) 新能源汽车、储能、工业自动化市场正处于高速增长期，项目具备市场可行性

新能源汽车领域，电动化转型持续深化，市场渗透率稳步提升。2026 年 3

月，国内新能源乘用车渗透率预计达 52.9%，再度恢复至 50%以上。根据中汽协预测，2026 年中国新能源汽车销量有望达 1,900 万辆，同比增长 15.2%。全球市场方面，TrendForce 预估 2026 年全球新能源车销量为 2,340 万辆，同比增长 14%。单车电池管理芯片用量与电池串数正相关，随着 800V 高压平台普及和单车带电量提升，车规级 BMIC 市场有望迎来量价齐升。

储能领域，全球能源转型加速推动储能需求爆发式增长。根据 CNESA 统计，2026 年 1 月中国新型储能市场开年向好，1 月新型储能投运规模同比增长超 60%。InfoLink Consulting 数据显示，2026 年全球储能电芯出货量预计达 801 GWh，系统新增装机量预计达 353 GWh。储能 BMS 市场随之快速扩张，QYResearch 数据显示，2025 年全球储能电池管理系统市场规模达 20.31 亿美元，预计 2032 年将增至 58.1 亿美元，年复合增长率高达 16.2%。

下游应用市场均处于高速增长通道，电池管理芯片作为电池系统的核心控制单元，将深度受益于终端需求的持续扩张。本项目的实施恰逢其时，能够精准把握市场机遇，满足下游产业对高性能、高可靠性国产 BMIC 的迫切需求。

(3) 项目依托公司多年的技术积累和大规模量产经验，具备技术可行性

公司经过多年技术积累，已形成完整的锂电池 AFE 及 AFE+MCU 一体化方案，覆盖 3C、电动两轮车、储能、电动工具等场景。公司在轻型电动车以及户储上已有大规模的应用与量产经验，在国内处于领先地位。车规电池 AFE 具有较高的技术壁垒，为了开发车规产品，公司已经取得 ISO 26262 功能安全开发流程认证（满足 ASIL-D 等级要求，ASIL-D 等级为汽车功能安全 ISO 26262 中最高等级），为车规产品的研发打下了坚实的基础。

本项目依托公司的人才优势、技术积累，能够顺利完成项目研发、流片、验证、工艺开发以及量产的全流程，降低项目实施风险，确保项目技术可行、风险可控、保障项目的顺利实施。

4、项目经济效益分析

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

5、项目涉及的政府报批情况

本次项目拟使用公司既有的场地，不涉及新增用地审批手续。

截至本报告出具日，本项目的备案手续尚在办理过程中。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价。

(二) 高端工业级（含车规）主控 SoC（含智能化）研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	高端工业级（含车规）主控 SoC（含智能化）研发及产业化项目
实施主体	中颖电子股份有限公司、西安中颖电子有限公司、合肥中颖电子有限公司
项目总投资	63,951.80 万元
项目建设期	4 年
项目建设内容	本项目将研发高可靠性、通过车规/工规认证的 SoC 芯片，产品可覆盖车身控制、BMS、工业/机器人关节控制、高端家电等多场景应用；项目将打造公司中高端 MCU 完整平台化产品体系，实现车规 MCU 产品批量上车应用与工业头部客户的导入，同时补充公司在家电领域的高端 MCU 产品矩阵。 本项目建设完成后，公司一方面可以在原有的家电 MCU 的基础上，拓展汽车，工业机器人产品矩阵，同时积极探索边缘 AI 在家电、工业、汽车上的应用，巩固并提高公司的竞争优势；另一方面，本项目将强化国产汽车芯片在性能、可靠性与成本上的优势，助力国产替代进程的加速。
建设地点	陕西省西安市、安徽省合肥市、上海市

2、项目实施的必要性

(1) 提升高端应用领域的 MCU 国产化率，保障供应链自主可控

当前，我国车载芯片对进口芯片的依赖程度依然较高。乘联分会数据显示，2025 年国内汽车芯片整体国产化率约 20%。车规级 MCU 细分领域虽已从不足 5%提升至 18%，但高端产品仍依赖进口。由于车载芯片对高可靠性、安全性及复杂工艺的严苛要求，国际巨头凭借长期积累形成技术壁垒，瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体等厂商合计占据全球 MCU 市场超八成份额，主导地位稳固。同时，汽车芯片产业发展仍面临技术研发投入大、车规认证周期长、市场推广难度高等多重挑战。

MCU 作为各类电子设备的“神经中枢”，应用场景极为广泛，其中，车载、工业领域是现阶段市场增长的核心板块。当前国内 MCU 市场呈现“低端饱和、高端短缺”的格局。在车载领域，随着汽车智能化、电动化的深度升级，“中央计算+区域控制”的汽车电子新架构逐步普及，对 MCU 芯片的算力、存储空间、接口资源提出更高要求；根据中商产业研究院预测，2025 年中国汽车 MCU 市场规模将达到 294 亿元。尽管国产化率已有所提升，但高端车规 MCU 市场仍被国际巨头主导，国产替代空间巨大。在工业领域，工业自动化、智能制造、物联网的快速发展，推动工业 MCU 芯片向高可靠性、高算力、低功耗方向升级，市场规模持续扩大，成为 MCU 行业重要的增长极。

本项目旨在实现车规 MCU 产品批量上车应用与工业头部客户的导入，同时补充公司在家电领域的高端 MCU 产品矩阵，在巩固并提高公司在工业、消费等领域的竞争优势的同时，强化国产汽车芯片在性能、可靠性与成本上的优势，助力国产替代进程加速，保障供应链自主可控。

(2) 把握快速增长的市场机遇，提升市场份额和品牌影响力

新能源汽车渗透率的提升及车辆智能化的发展将持续打开汽车芯片的增长空间。与传统燃油车相比，纯电动车动力系统更多依赖电动机和电动系统，对芯片的需求量也相应提升。同时，随着车辆智能化的发展，自动驾驶级别升高，传感器、主控芯片、存储芯片、功率半导体等多类型芯片的搭载量也将随之提升。据德勤的分析，L3 级别自动驾驶平均搭载 8 个传感器，而 L5 级别自动驾驶所需传感器芯片数量提升至 20 个。中国汽车工业协会数据显示，传统燃油车所需汽车芯片数量为 600-700 颗/辆，电动车所需数量则提升至 1,600 颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量约为 3,000 颗/辆。工业自动化领域，智能制造与工业 4.0 浪潮推动工厂自动化升级需求。据 GII 报告，全球工业自动化与控制系统市场规模预计从 2025 年的 2,151.3 亿美元增至 2033 年的 4,957.7 亿美元，2026-2033 年预计复合增长率达 11%。工业机器人、AGV、自动化产线等设备对 MCU 的需求持续释放，为高端工规 MCU 开辟了广阔的应用场景。

本项目聚焦汽车车身和座舱系统、工业电机控制等核心赛道，深化产品在车规、高端工规领域的应用，有助于公司把握快速增长的市场机遇，提升市场份额

和品牌影响力，为公司打造可持续、高壁垒的利润增长极。

(3) 完善 MCU 产品结构、拓宽产品应用范围，打开公司长期成长空间

公司已布局 MCU、BMIC 等产品，形成了一定的技术和市场基础，但车规级 BMIC、车规/高端工业 MCU 等产品领域仍处于拓展阶段，面临产品结构升级的迫切需求。

本项目研发完成后，公司将大幅拓展在汽车及工业高端领域的产品应用范围，完善公司整体 MCU 产品结构，增强公司在 MCU 领域的技术储备与竞争力，同时匹配公司整体的战略，与公司其它产品形成深度协同。具体而言，一是推动公司 MCU 产品从“消费级”向“车规+工业”全面升级，加强公司在车规、工业高端 MCU 领域的产品布局，实现公司产品结构的优化与升级。二是依托公司已有的 MCU 技术积累和优质客户资源，加速车规 MCU 产品的量产上车进程和工业头部客户的导入速度，持续提升公司在高端芯片领域的市场份额和品牌影响力。三是 MCU 作为核心主控芯片，可与公司 BMIC、电源芯片形成深度协同效应，强化公司“系统方案提供商”的市场定位，提升公司核心竞争力和市场议价能力，帮助公司打开长期成长空间。本项目的实施符合公司的发展战略，有助于公司拓宽产品应用范围，增加竞争壁垒。

3、项目实施的可行性

(1) 项目契合国家战略与产业政策导向，具备政策可行性

2020 年 10 月，国务院《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》首次将车规芯片与动力电池列为新能源汽车两大核心技术，明确提出到 2025 年实现“车规级芯片等关键核心技术取得重大突破”，至 2035 年达成“产业链供应链安全可控”的战略目标。2023 年 6 月，工业和信息化部等五部门联合发布《制造业可靠性提升实施意见》，在“基础产品可靠性‘筑基’工程”中，首次将 MCU 与 SoC、GPU 等并列，明确列为电子行业重点提升的高端通用芯片，要求重点提升其可靠性水平。2025 年 8 月，工业和信息化部《电子信息制造业稳增长行动方案》进一步提出，推动整机和零部件迭代升级，支持汽车电子、工业控制、医疗电子等产业发展，助推产业数字化转型。

项目研发方向围绕高端工业级（含车规）主控 SoC 芯片方向展开，与国家顶层设计高度同频，能够获得国家及产业政策支持。

（2）下游主要应用领域处于高速增长期，项目具备市场可行性

结合前述市场分析，新能源汽车、工业自动化等市场正处于高速增长期，BMIC、电源、MCU 作为三大领域的刚需芯片，市场规模持续扩大且国产替代空间巨大。当前国际厂商仍主导高端芯片市场，但存在交货周期长、产品价格偏高、技术响应滞后等痛点；国内车企、工业厂商为降低供应链风险，纷纷选择合规、可靠、服务响应快的国产芯片，为公司提供了良好的市场切入窗口。

公司现有产品以家电、消费类电子为主，已在 MCU 领域积累了深厚的技术基础与广泛的客户资源，具备向车规级及高端工业级市场升级的技术储备与市场衔接能力。本项目实施后，公司可依托现有客户资源，逐步拓展产品品类，在保障项目产品产能有效消化的同时，进一步增强客户黏性。此外，项目开发的新产品也将与现有产品线形成良好协同，有助于提升公司整体产品矩阵的综合竞争力。

（3）公司深耕芯片设计 20 余年，现有的 MCU 高可靠性设计经验可在车载、工业等领域实现复用，项目具备技术可行性

车规/工业芯片具有研发周期长、认证投入大、测试设备昂贵的特点，且需要持续的研发资金投入支撑技术迭代。公司深耕芯片设计领域 20 余年，在 MCU、电池管理、数模混合电路等核心领域积累了大量核心专利与 IP 资源，具备扎实的技术研发基础。在 MCU 领域，公司车规级 MCU 已经量产并成功通过 AEC-Q100 认证，复用家电 MCU 的高可靠性设计经验，有效缩短车规芯片的开发周期，产品 EMC 性能指标优于行业平均水平。此外，公司已取得 ISO 26262 功能安全开发流程认证（满足 ASIL-D 等级要求）。

公司注重研发人才的培养和储备体系，公司经过多年的发展形成了一支专业的研发人才队伍，分布于产品的系统规划、模拟和数字电路设计、制造工艺技术、测试技术等各个专业。截至 2025 年末，在公司服务五年以上的研发人员人数占比超 50%，人员稳定性较强。同时，公司拥有完备的人才招聘、培养机制，能够及时引进有丰富经验的专业人才，跟踪先进技术的发展方向，保证公司技术产品

的先进性，不断增强公司的人才储备。

4、项目经济效益分析

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

5、项目涉及的政府报批情况

本次项目拟使用公司既有的场地和新增租赁办公楼，不涉及新增用地审批手续。

截至本报告出具日，本项目的备案手续尚在办理过程中。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价。

（三）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 42,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展对营运资金的需求，满足公司业务发展需求。

2、项目实施的必要性

（1）补充营运资金，满足公司业务发展需求

公司坚持“聚焦芯片设计主业，向车规、工业高端领域升级”的核心战略布局，主要经营策略为：（1）重视内生式增长：持续保持高力度的研发投入，吸引优秀人才加入，以技术力提升产品的国际竞争力；（2）把握外延式发展机遇：积极与芯片设计行业内有协同效应的友商，进行业务或并购合作，以扩大规模效应，增强国际竞争力，提升抗风险能力。本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金，有助于优化公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，为公司的内生式增长与把握外延式发展机遇提供有力的资金支持，满足公司业务发展需求，提高公司的可持续经营能力。

（2）巩固上市公司控制权，提升公司投资者信心

本次发行由致能工电全额认购，本次发行完成后公司控股股东控制公司股份

比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，致能工电认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

3、项目实施的可行性

(1) 本次向特定对象发行股票符合相关法律法规

本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司目前的发展阶段，以及公司所处行业特征，有利于公司加强研发投入，吸收优秀人才，增强公司资金实力和抗风险能力，满足公司日常经营的各项资金需求，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，具有可行性。

(2) 公司具备完善的治理结构与有效的内控执行能力

公司已按照上市公司的治理标准，形成了较为规范、标准的公司治理体系和规范有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更投向、管理与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

本次募投项目均围绕公司“聚焦芯片设计主业，向车规、工业高端领域升级”的核心战略布局，既是对公司现有产品矩阵的完善与升级，也是对行业市场机遇的精准把握，对公司突破现阶段发展瓶颈、持续提升核心竞争力具有决定性的战略意义。本次募投项目建成投产后，将丰富和拓展公司各个产品线的系列谱系，进一步提高公司产品的竞争力和市场份额，有利于巩固公司的市场地位，促进公司可持续发展，带动半导体产业链上下游的协同发展。同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于增强公司资金实力，为经营活动的高效开展提供有力支持，也有助于进一步增强公司控制权的稳定性，提升公司整体投资价值，符合公司及

全体股东的利益。

(二) 对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司总资产与净资产规模均相应增加,营运资金更加充裕,资产负债结构更为合理。本次募集资金投资项目中高端工业级(含车规)模拟、数模混合芯片研发及产业化项目,高端工业级(含车规)主控 SoC(含智能化)研发及产业化项目具有良好的经济效益,虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益,公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升,有利于增强公司综合竞争实力,促进公司持续健康发展,为公司股东贡献回报。

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

综上所述,本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及全体股东的利益。同时,本次向特定对象发行股票有利于增强公司的盈利能力及核心竞争力,优化公司的资本结构,提升公司的影响力,为后续业务发展提供保障。综上所述,本次募集资金投资项目具有实施的可行性。

中颖电子股份有限公司董事会

2026年4月3日